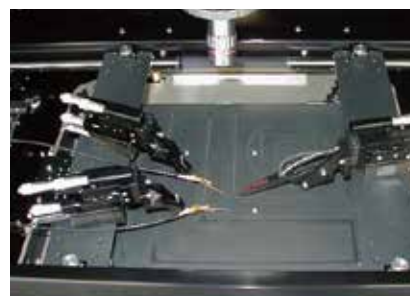


大型基板対応の評価・解析用マニュアルプローバ

- ・大型ステージの搭載により、12インチウェーハ、FPD基板の不良解析やTEG評価に対応。
- ・スライドテーブルの採用により、広範囲なプロービングエリアを確保。
- ・エアベアリングステージ採用により、片手で簡単に操作可能。
- ・3段切り替えレバーによるセーフティロック機構を搭載。コンタクト時の操作ミスによるデバイスやプローブの損傷を防止。
- ・各種顕微鏡、レーザーカッターシステムの搭載など、使用目的に合わせたカスタマイズが可能。

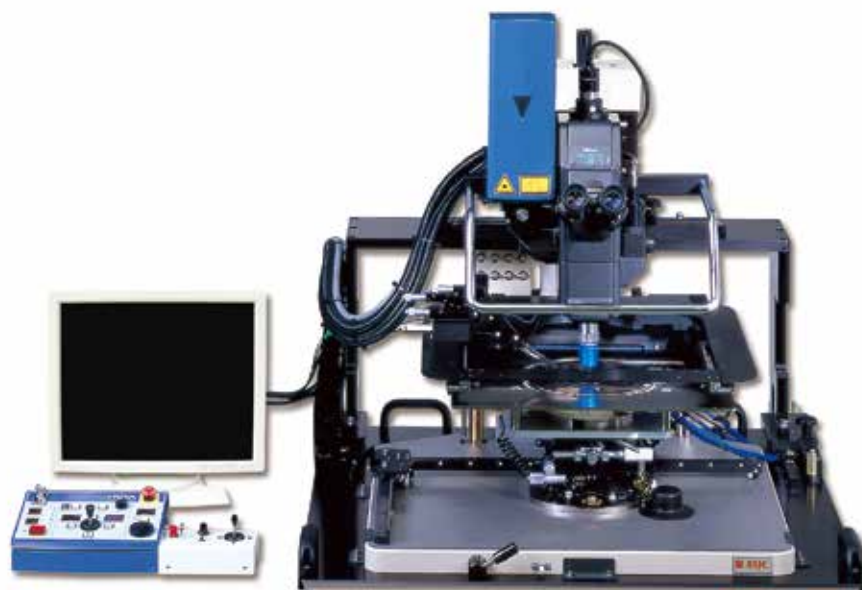
705A-WG7 仕様

最大デバイスサイズ	ウェーハ	φ300mm
	大型基板	500 × 400mm
ステージ移動範囲 (粗動)	X:500mm Y:400mm	
ステージ移動範囲 (微動)	X:25mm Y:25mm	
Z軸 ステージストローク	0 / 0.3 / 3.5mm + 37.5mm	
θ軸 ステージ回転角度	粗動 ±45°	
	微動 ±5°	
外形寸法 (W×D×H)	978 × 1,038 × 748mm (オプション含まず)	
装置重量	130kg (オプション含まず)	



705A-WG7 Options

- ・マイクロマニピュレータ
- ・同軸プローブ・精密プローブ針
- ・同軸ケーブル
- ・変換コネクタ
- ・シールドボックス
- ・温度コントローラ・ホットチャック
- ・顕微鏡・レーザーカッターシステム・CCDカメラ
- ・チャックトップ



Manual prober for evaluation / analysis of large substrate

- Applicable for analysis or evaluation of TEG on 12 inch wafer, FPD panel by adopting larger size stage.
- Slide table for securing wide probing area.
- Air bearing stage for easy one-handed operation.
- 3-step adjustment lever with safety-lock mechanism to prevent damage to devices and probes caused by improper contact operation.
- Customizable according to the intended use, for example, with addition of microscope or laser cutter systems.

705A-WG7 Specifications

Maximum device size	Wafer	φ 300mm
	Large substrate	500 × 400 mm
Stage travel (rough adjustment)	X : 500 mm	Y : 400 mm
Sub-stage travel (fine adjustment)	X : 25 mm	Y : 25 mm
Z stroke	0 / 0.3 / 3.5 mm + 37.5 mm	
θ travel	Rough adjustment : ±45°	
	Fine adjustment : ±5°	
External dimensions (W x D x H)	978 × 1,038 × 748 mm (excluding options)	
Weight	130 kg (excluding options)	

705A-WG7 Options

- Micro manipulators
- Coaxial probes and precision probe needles
- Coaxial cables
- Conversion connectors
- Shielding boxes
- Temperature controllers and hot chucks
- Microscopes, laser cutter systems and CCD camera
- Chuck top

